



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D209199 S

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 01 月 01 日

(21)申請案號：109301937D01

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 04 月 10 日

(51)LOC.(11)Cl.：15-99

(30)優先權：2019/10/25 日本

2019-023720

(71)申請人：日商昭和電工材料股份有限公司 (日本) SHOWA DENKO MATERIALS CO.,LTD.
(JP)

日本

(72)設計人：尾崎義信 OZAKI, YOSHINOBU (JP)；田澤強 TAZAWA, TSUYOSHI (JP)；谷口
紘平 TANIGUCHI, KOHEI (JP)；矢羽田達也 YAHATA, TATSUYA (JP)；板垣圭
ITAGAKI, KEI (JP)

(74)代理人：葉璟宗；卓俊傑

(56)參考文獻：

TW I470682

TW I584381

TW D110392

TW D122285

TW D124446

TW D130502

TW D132339

TW D164160

TW D172417

TW D173082

TW D173083

TW D175850

TW D175851

TW 200937508

TW 201622010

TW 201934683

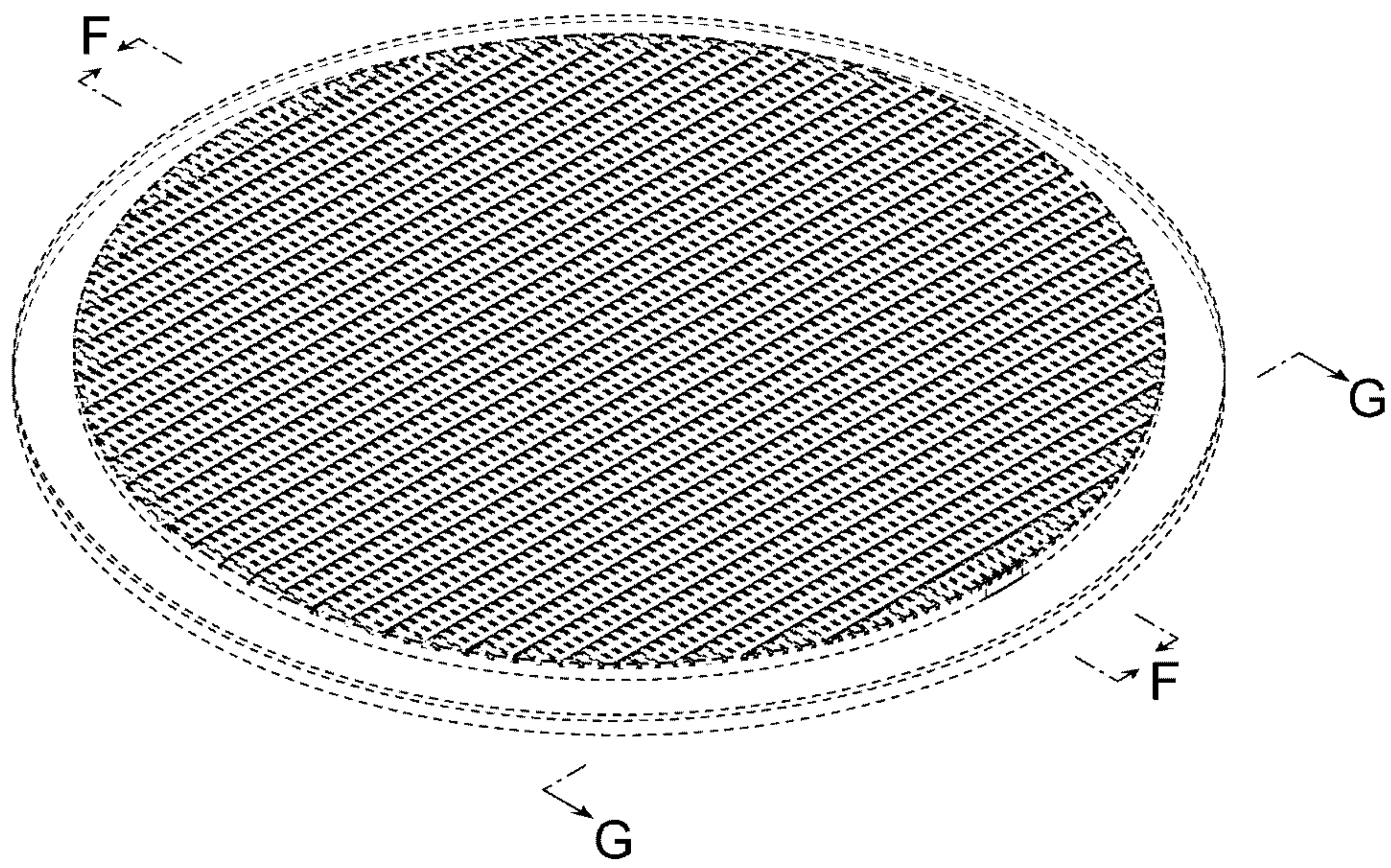
審查人員：徐銘鋒

圖式數：18 共 18 頁

(54)名稱

製造半導體裝置用的膜片

代表圖：



【立體圖1(代表圖)】



公告本

D209199

【衍生設計說明書】

【中文設計名稱】製造半導體裝置用的膜片

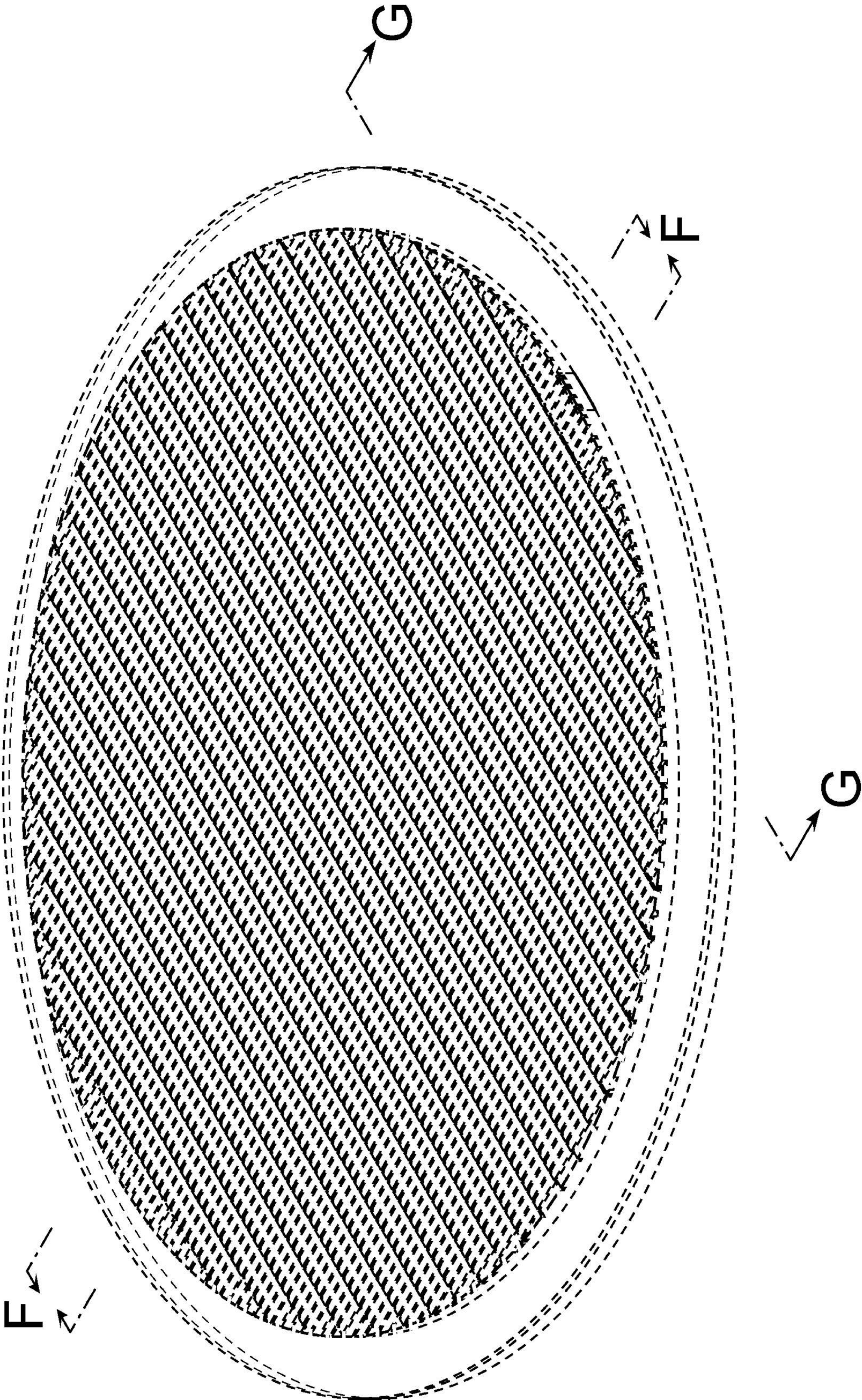
【英文設計名稱】FILM FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE

【物品用途】

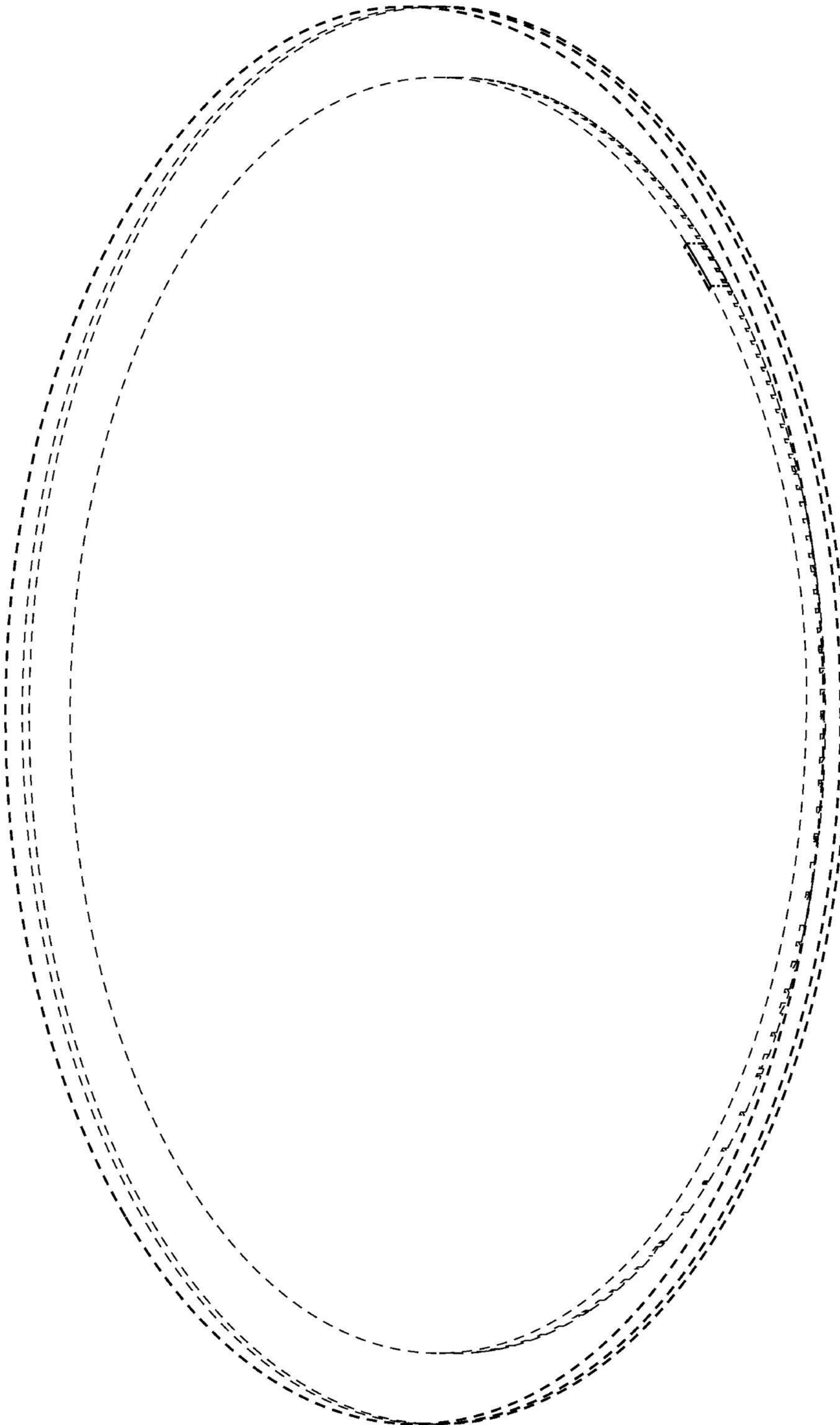
【0001】 本設計物品是一種製造半導體裝置用的膜片。

【設計說明】

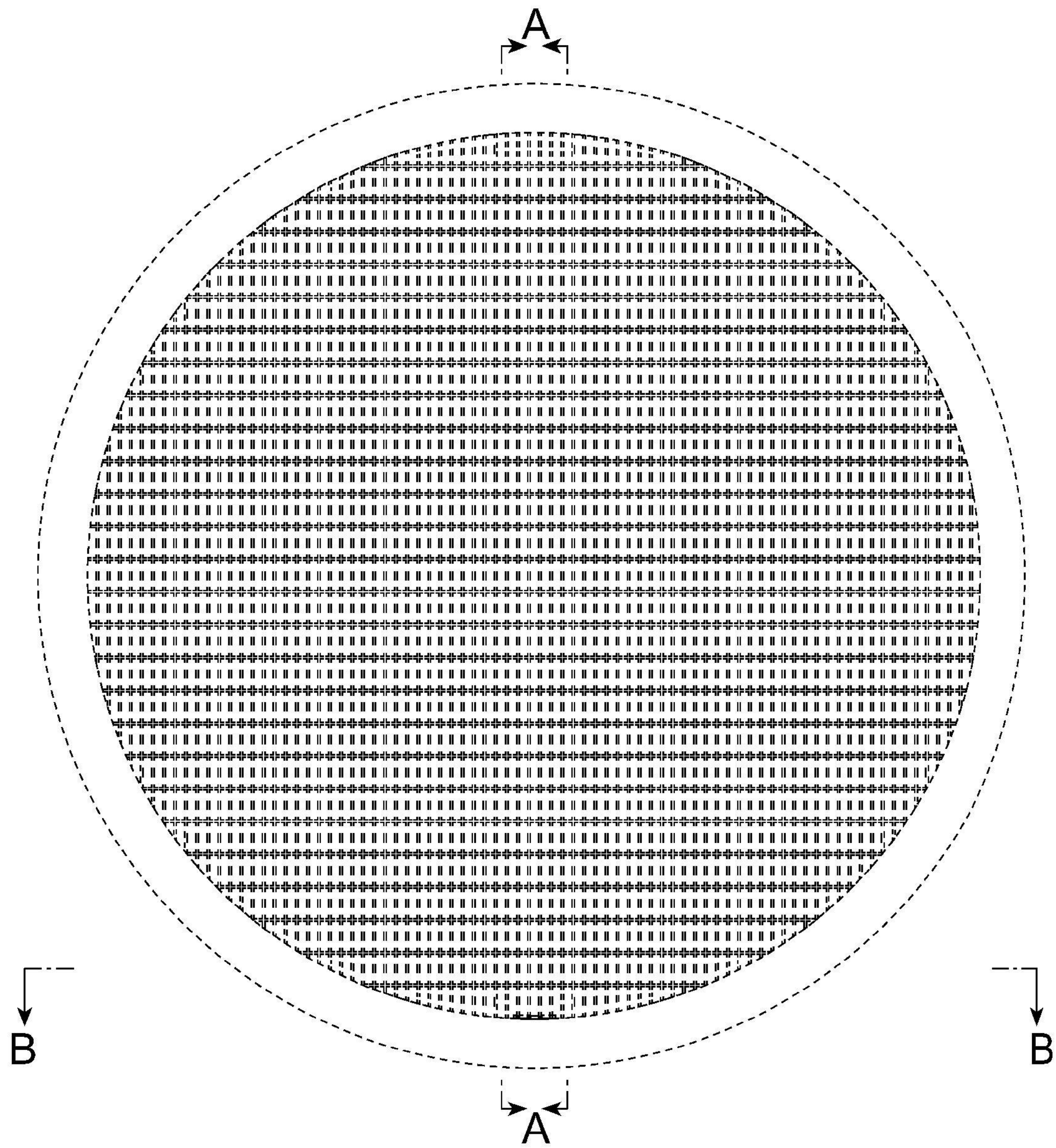
【0002】 本設計圖式所揭露之虛線為本案不主張設計之部分。圖式中一點鏈線所圍繞者，係界定本案所欲主張之範圍，該一點鏈線本身為本案不主張設計之部分。顯示使用狀態的參考視圖 1 和 2 表示本設計之物品及所應用環境中之各部件名稱，其中本設計應用之物品係由基膜與黏著劑層、成膜支撐構件所構成，黏著劑層和基膜是透明的。



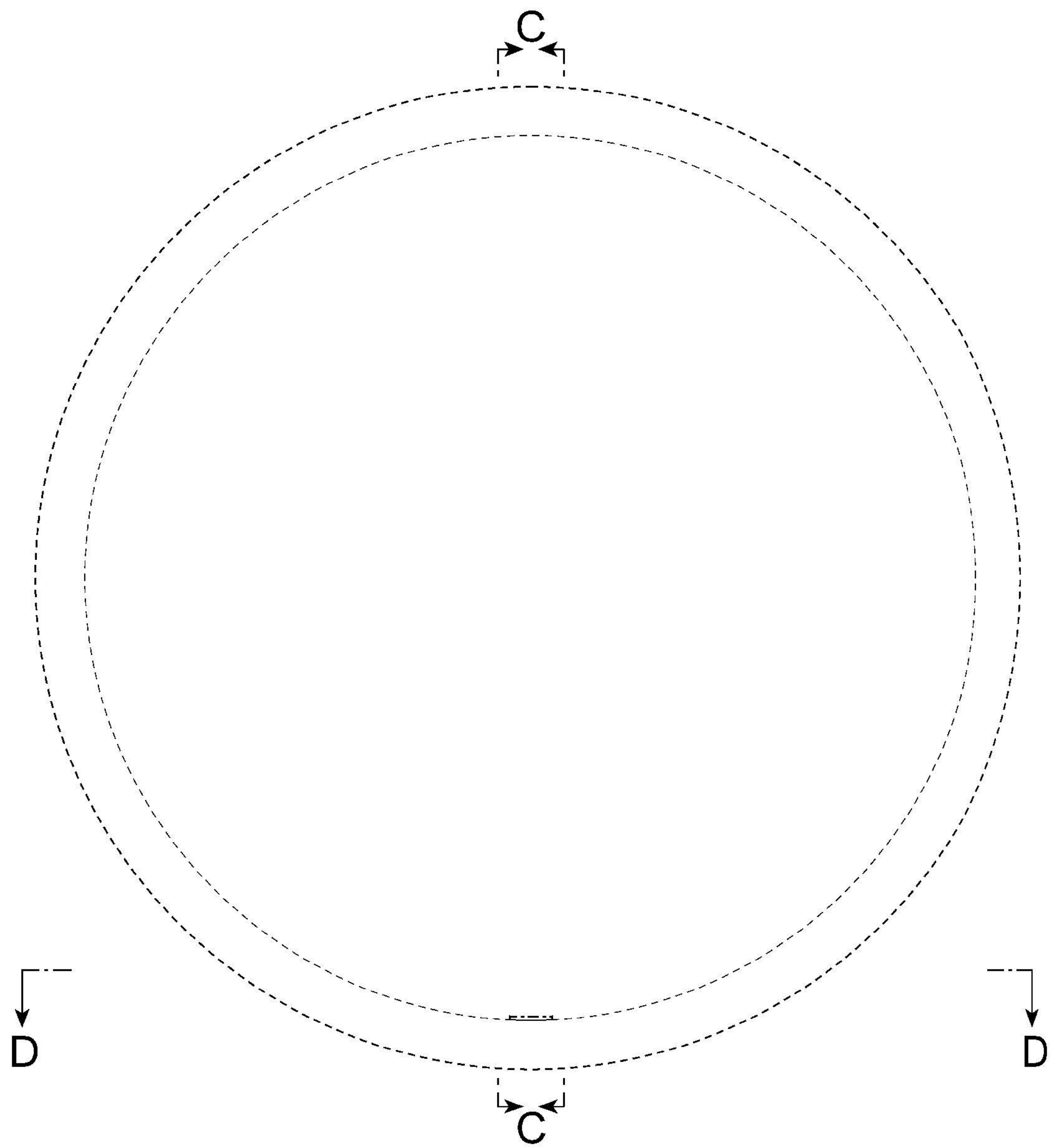
【立體圖1(代表圖)】



【立體圖2】



【前視圖】



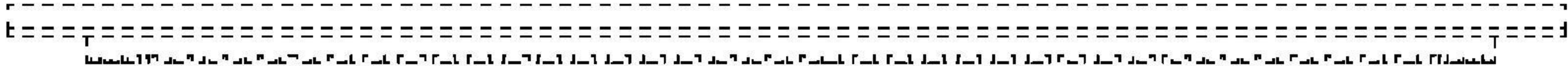
【後視圖】



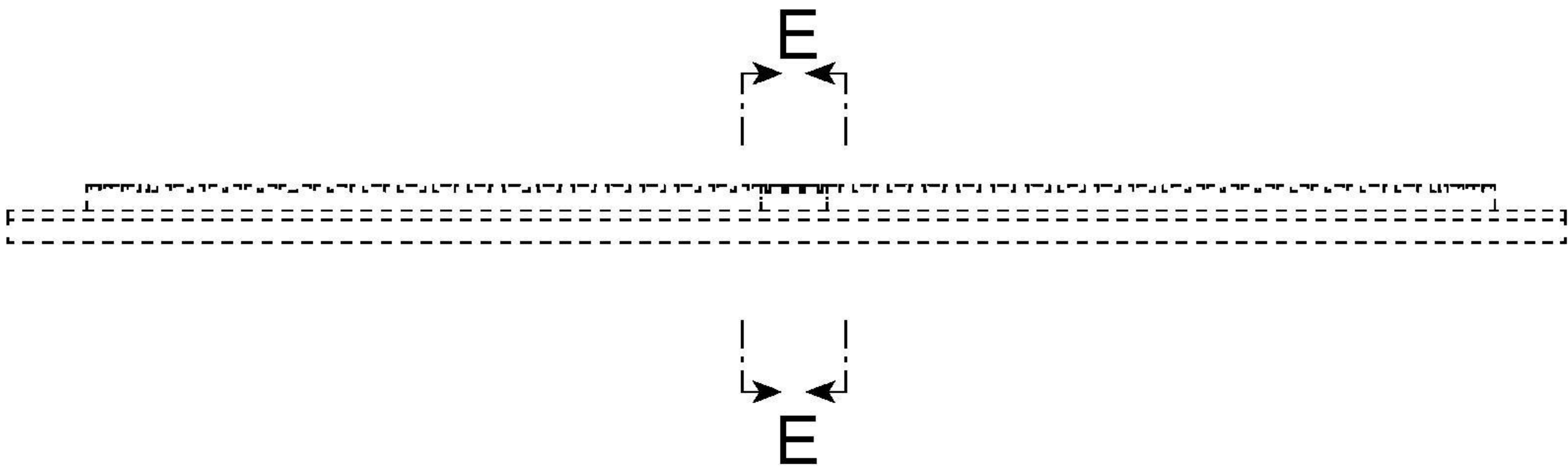
【左側視圖】



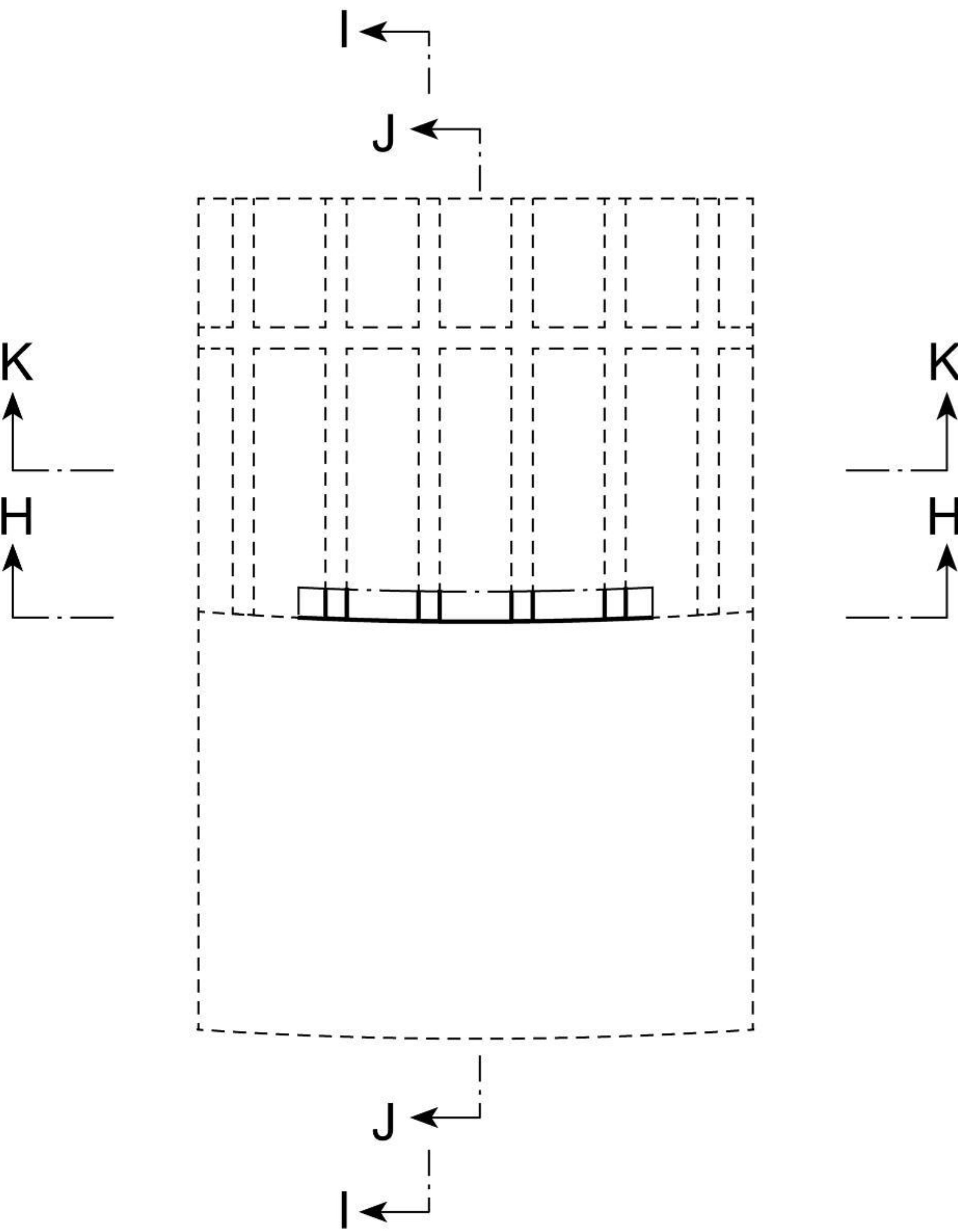
【右側視圖】



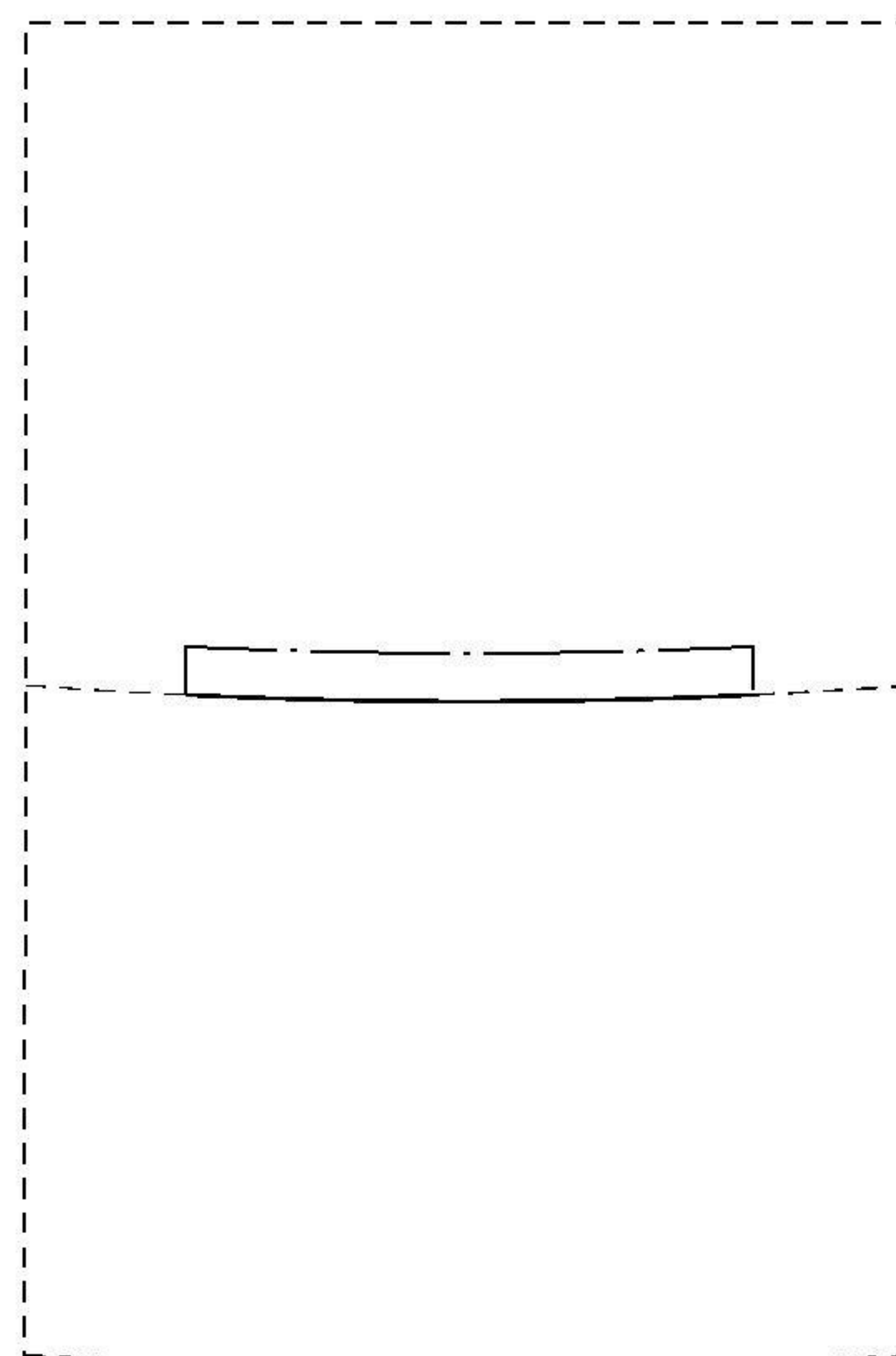
【俯視圖】



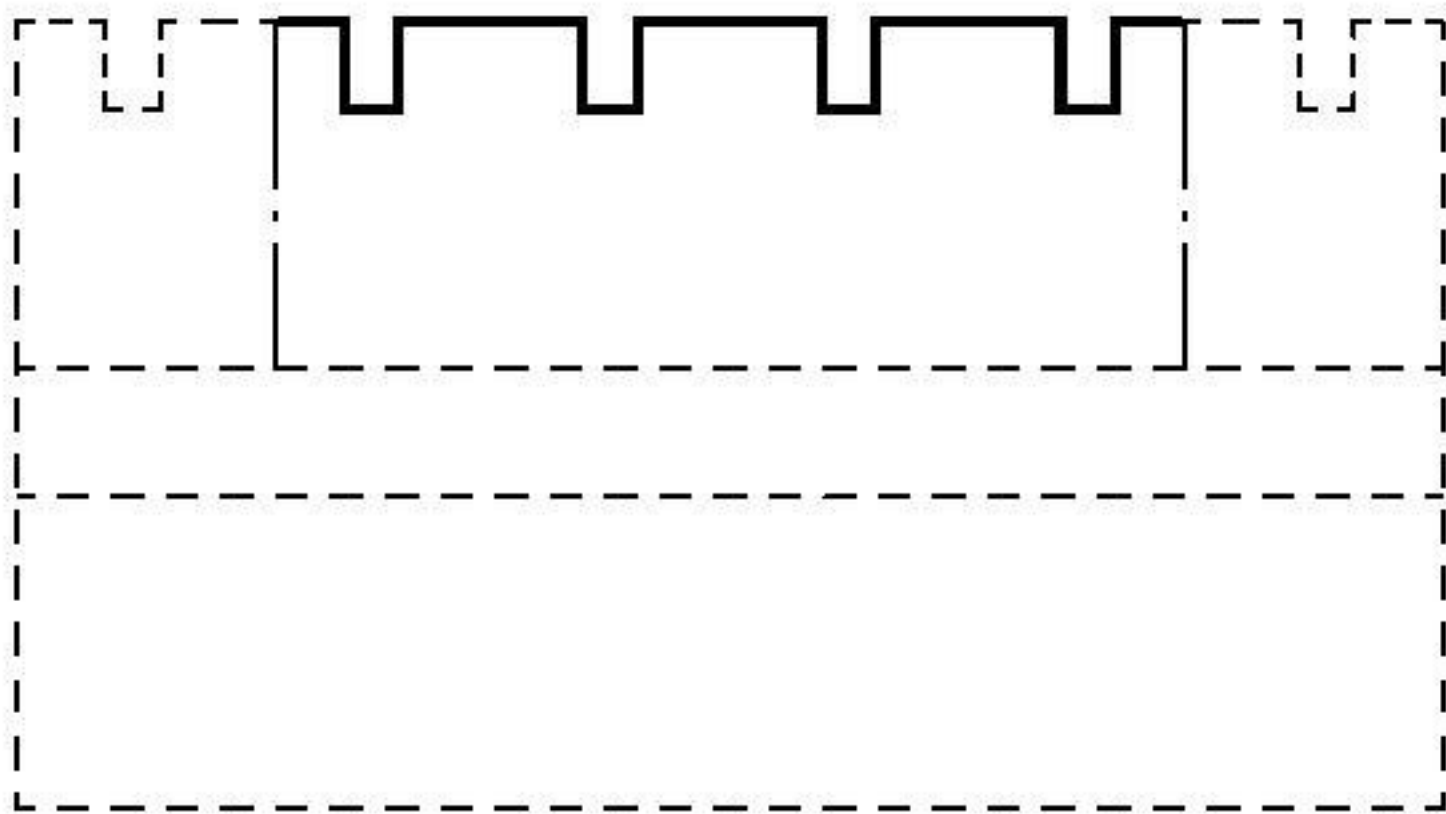
【仰視圖】



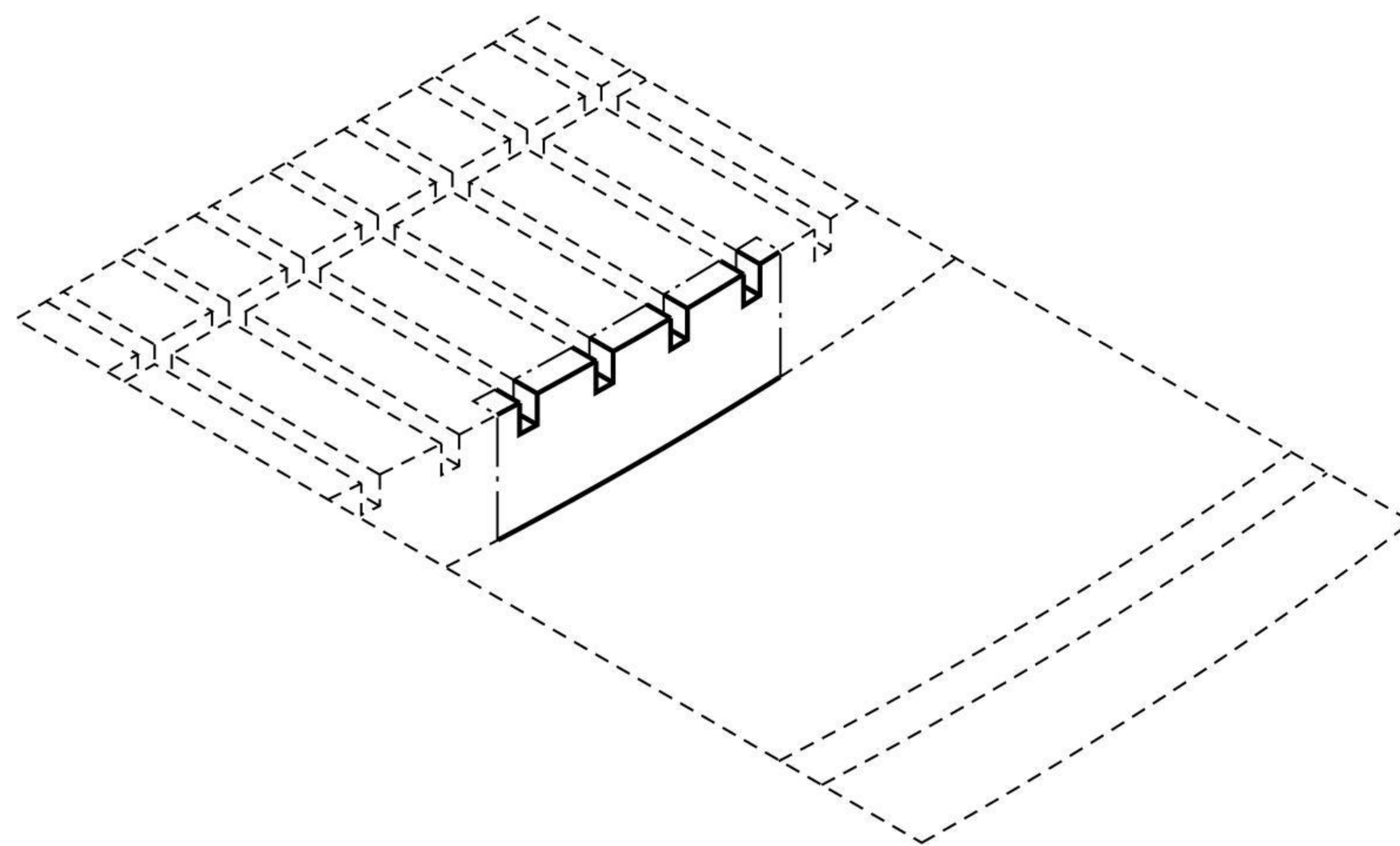
【A-A，B-B部分的局部放大圖】



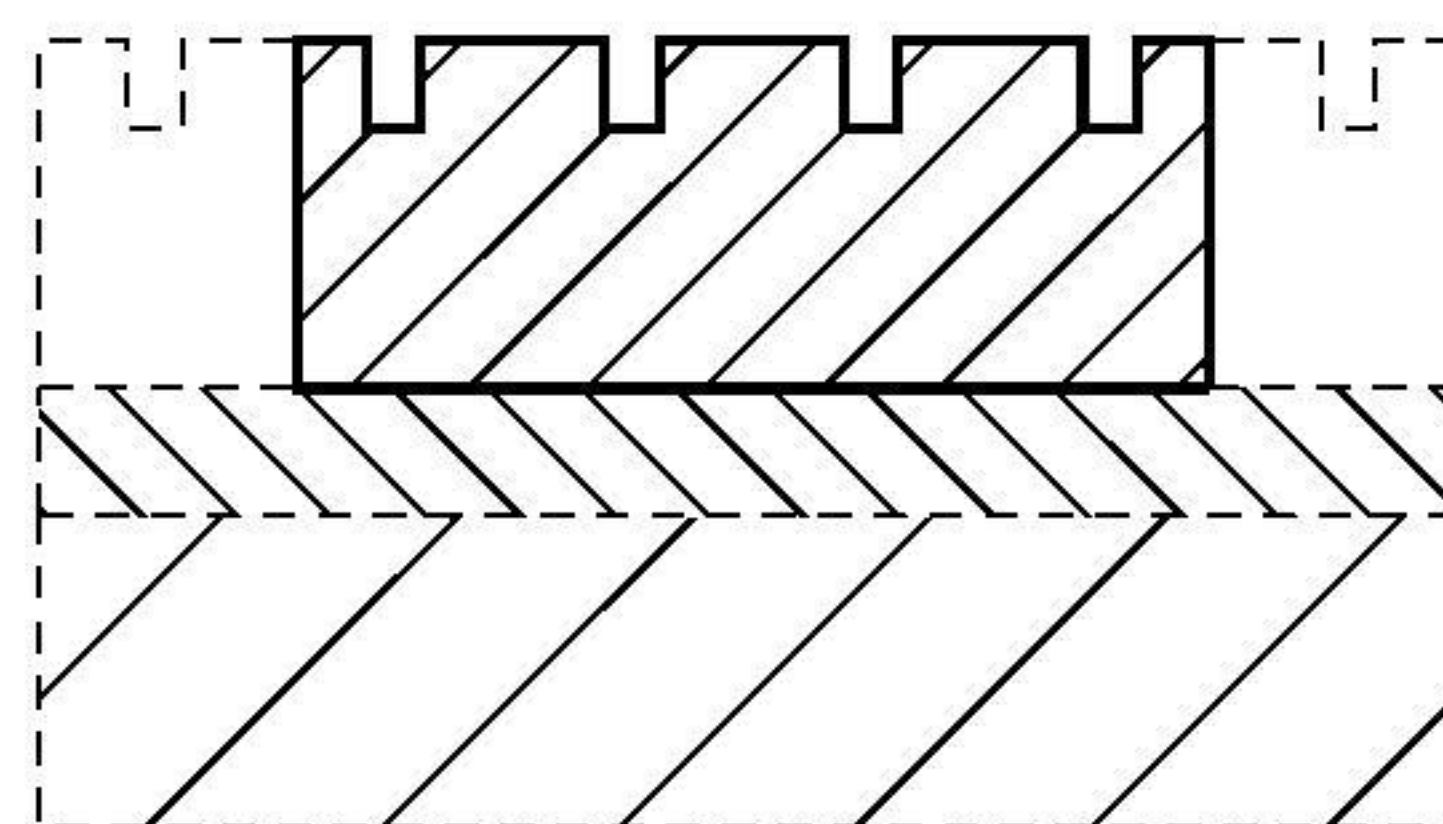
【C-C，D-D部分的局部放大圖】



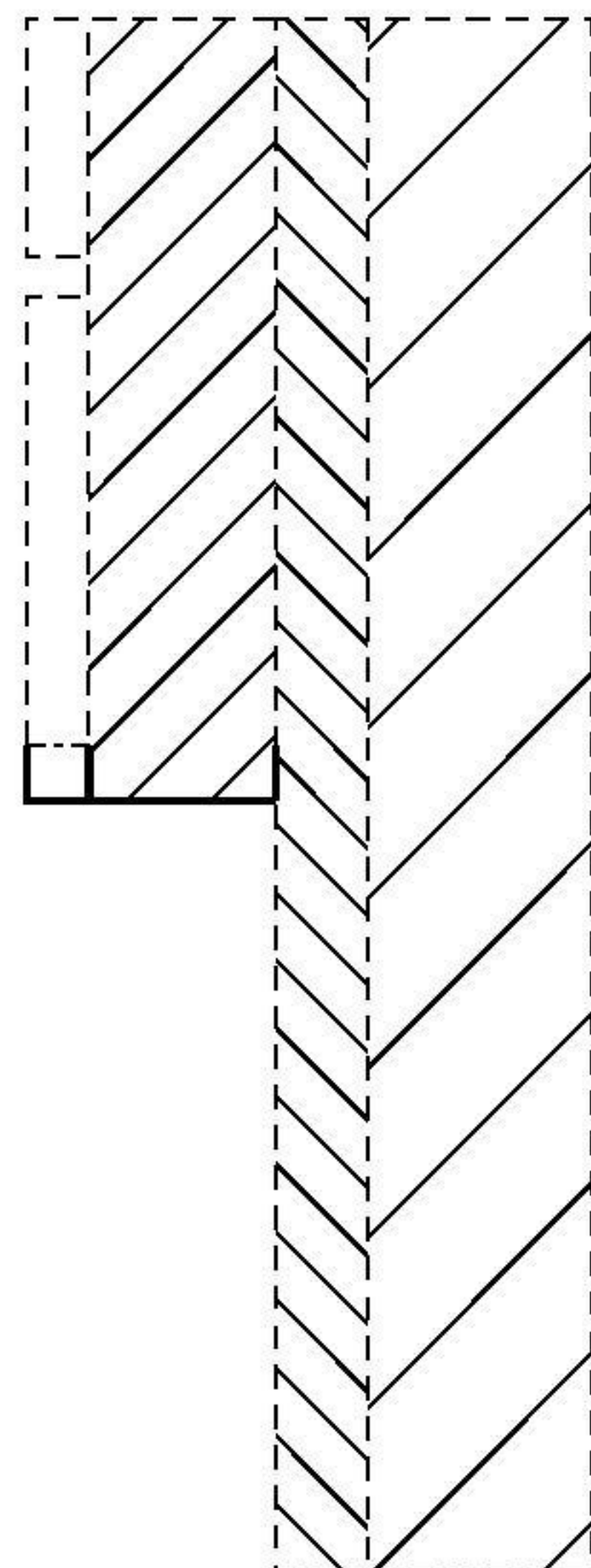
【E-E部分的局部放大圖】



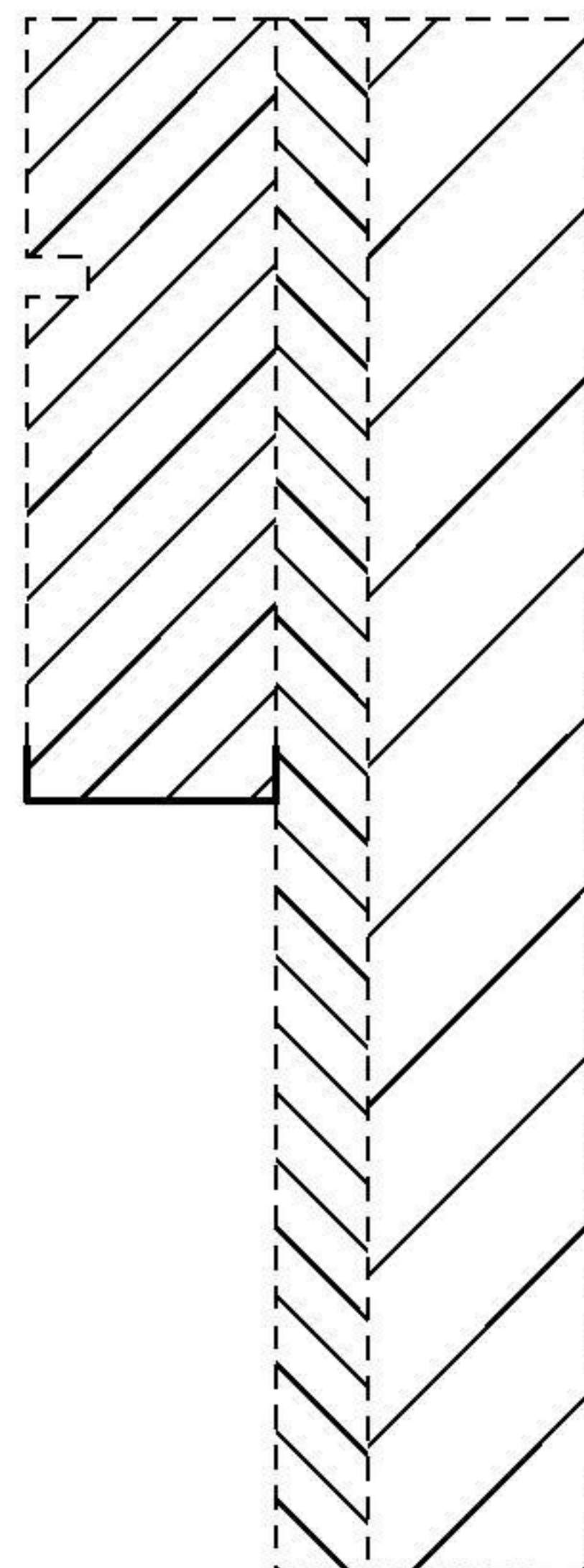
【F-F，G-G部分的局部放大圖】



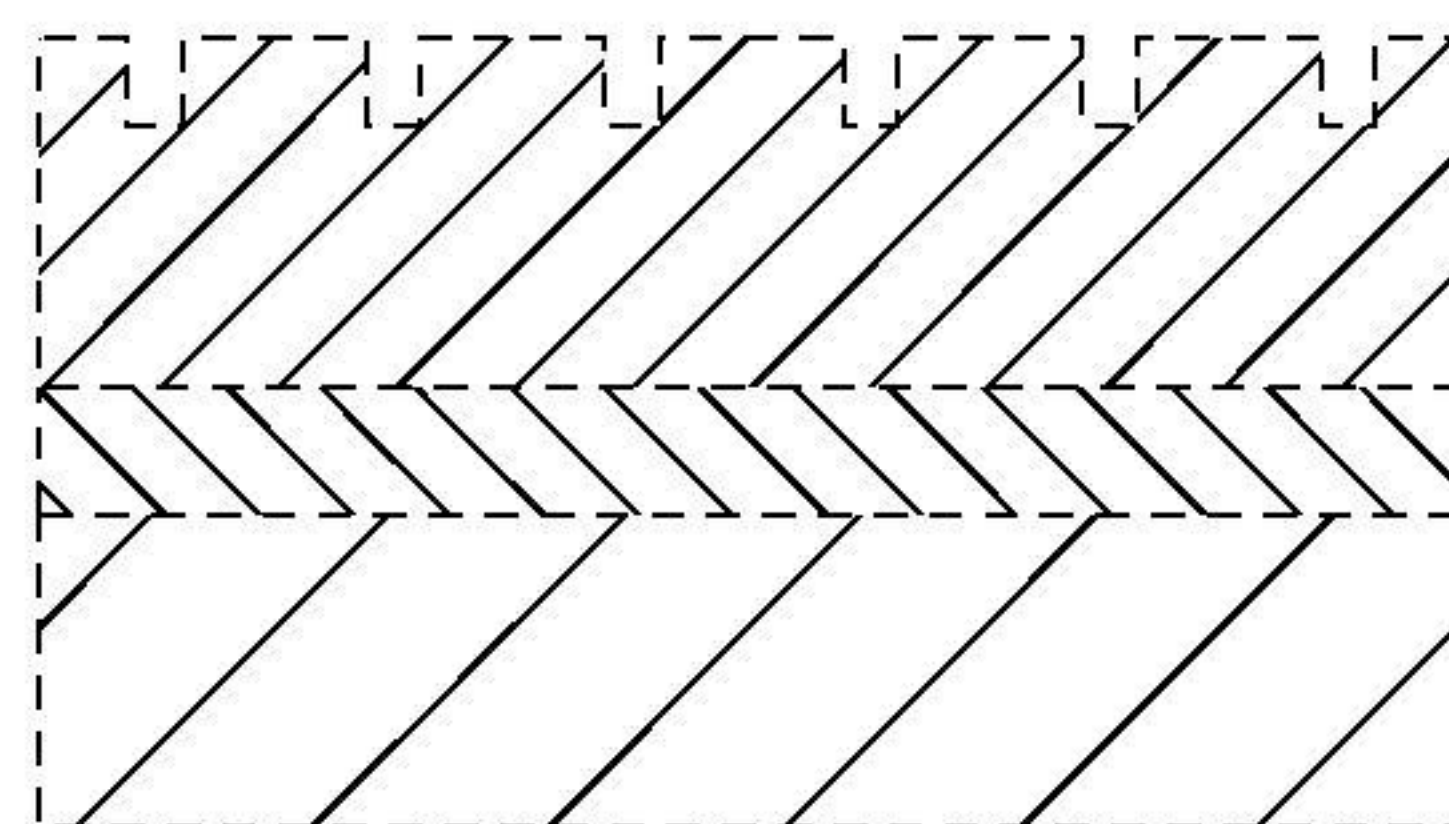
【H-H剖面圖】



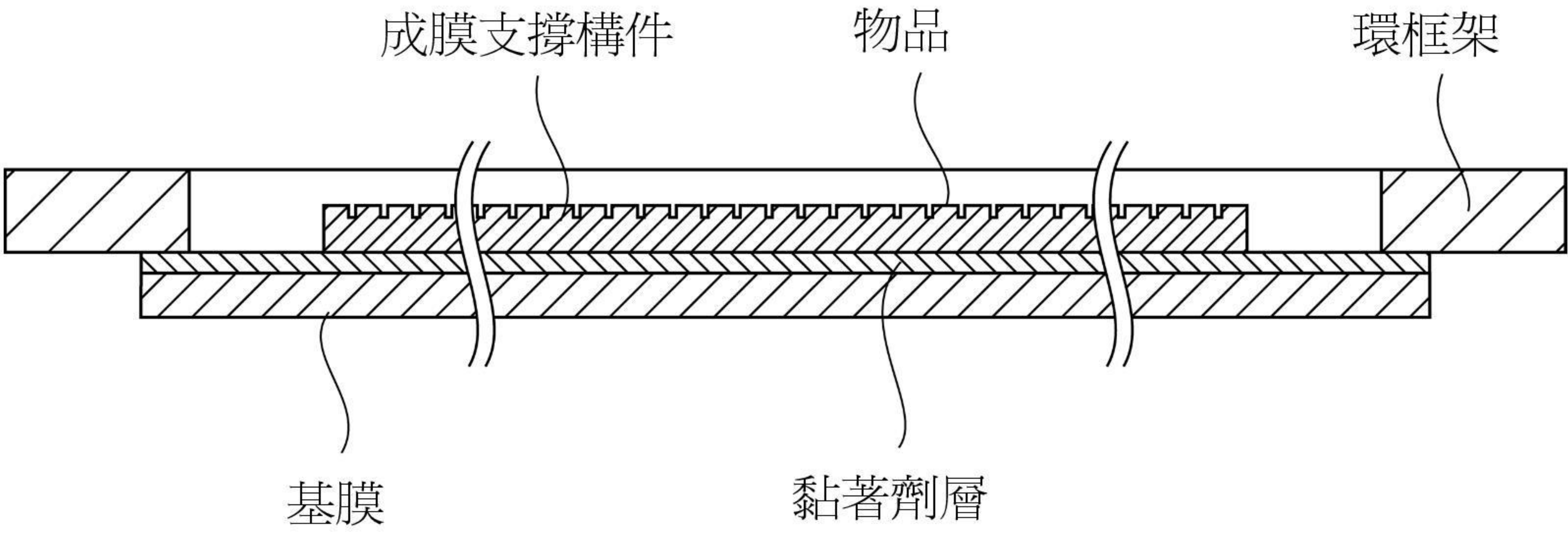
【I-I剖視圖】



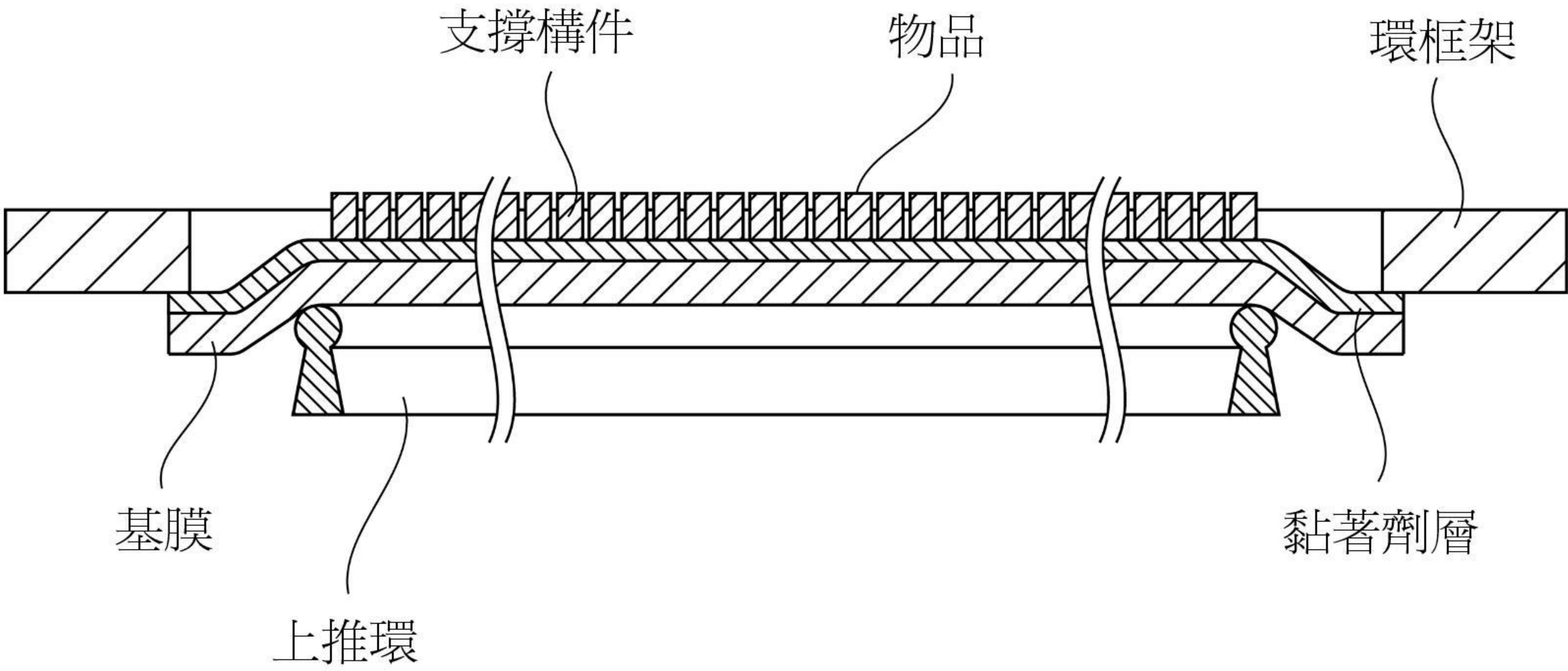
【J-J剖視圖】



【K-K剖視圖】



【顯示使用狀態參考視圖1】



【顯示使用狀態參考視圖2】